

1. Record Nr.	UNINA9910780716803321
Autore	Beuerle Angela
Titolo	Sprachdenken im Mittelalter [[electronic resource]] : ein Vergleich mit der Moderne / / Angela Beuerle
Pubbl/distr/stampa	Berlin ; ; New York, : Walter de Gruyter, c2010
ISBN	1-282-67301-7 9786612673016 3-11-021502-0
Descrizione fisica	1 online resource (513 p.)
Collana	Studia linguistica Germanica ; ; 99
Classificazione	ER 535
Disciplina	401 410
Soggetti	Linguistics - History
Lingua di pubblicazione	Tedesco
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Nota di contenuto	Frontmatter -- Inhaltsverzeichnis -- Einleitung -- I. Leben, Werk, Kontext -- A. Martinus und Boethius de Dacia und die modistische Grammatik -- B. Ferdinand de Saussure und der Cours -- II. Bedingungen einer Wissenschaft von der Sprache -- A. Boethius de Dacias Definition von Wissenschaft und Sprachwissenschaft -- B. Saussures Darstellung der Sprachwissenschaft im Cours -- III. Beschreibungen der Sprache -- A. Die modistische Grammatik bei Martinus und Boethius de Dacia -- B. Saussures Sprachbeschreibung im Cours im Vergleich mit der modistischen Grammatik bei Martinus und Boethius de Dacia -- IV. Die isländischen Grammatischen Traktate -- A. Zum Inhalt der Traktate -- B. Die isländischen Traktate: Kontext und Vergleich -- V. Wissenschaft und Grammatik -- Eine wissenschaftstheoretische Betrachtung der sprachtheoretischen Ansätze -- Backmatter
Sommario/riassunto	Im Zentrum dieses Bandes stehen die um 1270 in Paris entstandenen lateinischen Traktate der Dänen Martinus und Boethius de Dacia zur sog. "modistischen Grammatik", die in konziser und umfassender Weise den Versuch unternehmen, Sprache als einen wissenschaftlichen Gegenstand eigener Ordnung theoretisch zu beschreiben und damit ein eigenständiges Fach im Rahmen der neu entstehenden Universität zu

begründen. Die Konturen dieser "mittelalterlichen Linguistik" werden deutlich in einer komparatistischen Gegenüberstellung mit zwei weiteren, ganz unterschiedlichen sprachtheoretischen Ansätzen: (1) vier Traktaten mittelalterlicher isländischer Grammatiker, in denen sich ein Sonderweg mittelalterlicher Sprachbeschreibung beobachten lässt, und (2) Saussures "Cours de linguistique générale" als einem Grundlagenwerk der modernen Linguistik. So ergibt sich ein Vergleich zweier sprachwissenschaftlicher Epochen, die in ihrer systematischen Herangehensweise verbunden, in ihrer Auffassung vom Verhältnis zwischen Sprache und Realität jedoch diametral entgegengesetzt sind. Dies mündet in eine grundlegende wissenschaftstheoretische Reflexion einer möglichen Typologie sprachwissenschaftlicher Theoriegebäude.

2. Record Nr.	UNINA9910299492803321
Autore	Noia Brandon
Titolo	Design-for-test and test optimization techniques for TSV-based 3D stacked ICs // Brandon Noia, Krishnendu Chakrabarty ; foreword by Vishwani Agrawal
Pubbl/distr/stampa	Cham, Switzerland : , : Springer, , 2014
ISBN	3-319-02378-0
Edizione	[1st ed. 2014.]
Descrizione fisica	1 online resource (xviii, 245 pages) : illustrations (chiefly color)
Collana	Gale eBooks
Disciplina	004.1 537.622 620 621.3815
Soggetti	Three-dimensional integrated circuits
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Nota di contenuto	Introduction -- Wafer Stacking and 3D Memory Test -- Built-in Self-Test for TSVs -- Pre-Bond TSV Test Through TSV Probing -- Pre-Bond TSV Test Through TSV Probing -- Overcoming the Timing Overhead of Test Architectures on Inter-Die Critical Paths -- Post-Bond Test Wrappers and Emerging Test Standards -- Test-Architecture Optimization and Test Scheduling -- Conclusions.

This book describes innovative techniques to address the testing needs of 3D stacked integrated circuits (ICs) that utilize through-silicon-vias (TSVs) as vertical interconnects. The authors identify the key challenges facing 3D IC testing and present results that have emerged from cutting-edge research in this domain. Coverage includes topics ranging from die-level wrappers, self-test circuits, and TSV probing to test-architecture design, test scheduling, and optimization. Readers will benefit from an in-depth look at test-technology solutions that are needed to make 3D ICs a reality and commercially viable. • Provides a comprehensive guide to the challenges and solutions for the testing of TSV-based 3D stacked ICs; • Includes in-depth explanation of key test and design-for-test technologies, emerging standards, and test-architecture and test-schedule optimizations; • Encompasses all aspects of test as related to 3D ICs, including pre-bond and post-bond test as well as the test optimization and scheduling necessary to ensure that 3D testing remains cost-effective. .
